

斯达半导体股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到位情况

1、2020年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019] 2922号)核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,000.00万股，发行价格为每股12.74元。

公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000.00万股，募集资金总额人民币50,960.00万元，扣除承销费和保荐费人民币3,500.00万元（含税价）后的募集资金为人民币47,460.00万元，已于2020年1月21日全部到账。本次募集资金总额人民币50,960.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,010.67万元后，实际募集资金净额人民币45,949.33万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2020]第ZA10026号验资报告。

2、2021年非公开发行股票

2021年9月，中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021] 3201号)核准公司非公开发行不超过1,600万股新股。

公司实际向J.P. Morgan Chase Bank, National Association、富国基金管理有限公司、BARCLAYS BANK PLC等14位认购人合计发行人民币普通股股票10,606,060股，每股面值1.00元，发行价格330.00元/股，共计募集资金人民币349,999.98万元，扣除承销费人民币2,200.00万元（含税价）后的募集资金为人民币347,799.98万元，已于2021年11月3日全部到账。本次募集资金总额人民币349,999.98万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币2,304.93万元后，实际募集资金净额人民币347,695.05万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第ZA15756号验资报告。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《嘉兴斯达半导体股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。

1、2020年首次公开发行股票

2020 年 1 月 23 日，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司嘉兴分行营业部、杭州银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 6 月 29 日，子公司上海道之科技有限公司（以下简称上海道之）与公司作为募投项目新能源汽车用 IGBT 模块扩产项目实施主体，会同保荐机构中信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按监管协议的规定履行，不存在重大问题。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金户的存储情况如下：

账户名称	开户银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
嘉兴斯达半导体股份有限公司	交通银行股份有限公司嘉兴分行营业部	334899991013000045994	117,991,300.00	
嘉兴斯达半导体股份有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	19310101040021256	200,000,000.00	
嘉兴斯达半导体股份有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000575875	156,608,700.00	
上海道之科技有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000630548		
合计			474,600,000.00	

注：截止2024年12月31日，上述募集资金专户已办理销户手续。

2、2021年非公开发行股票

2021年11月15日，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年11月26日，嘉兴斯达微电子有限公司（以下简称斯达微电子）与公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年3月22日，为进一步提高募投项目的实施效率，更好保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加募集资金专户的议案》，公司新增募集资金专用账户并与相关方签署《募集资金监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按监管协议的规定履行，不存在重大问题。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金户的存储情况如下：

账户名称	开户银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日 余额
斯达半导体股份有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000746187	700,000,000.00	
斯达半导体股份有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	19310101040050016		
斯达半导体股份有限公司	中国民生银行嘉兴分行	633749183	1,977,999,800.00	
斯达半导体股份有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	19310101040024557	800,000,000.00	
嘉兴斯达微电子有限公司	交通银行股份有限公司嘉兴分行	334899991013000255187		
嘉兴斯达微电子有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	19310101040033368		
嘉兴斯达微电子有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000749264		
合计			3,477,999,800.00	

注：截止2024年12月31日，上述募集资金专户已办理销户手续。

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

1、 2020年首次公开发行股票

截止2024年12月31日，本公司前次募集实际使用情况详见附表1《2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、 2021年非公开发行股票

截止2024年12月31日，本公司前次募集实际使用情况详见附表2《2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、 2020年首次公开发行股票

截止2020年6月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币6,148.06万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA15013号）。

上述代垫投入的自筹资金，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事、公司监事会、发表明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。信息披露情况请见公司于 2020年6月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-035）。

2、 2021年非公开发行股票

截止2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际投资金额为人民币16,088.32万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA10711号）。

上述代垫投入的自筹资金经公司第四届第十六次董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。信息披露情况请见公司于2022年4月8日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-013）。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1) 2020年首次公开发行股票

公司于2020年6月23日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过10,000.00万元暂时闲置募集资金用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了核查意见。截至2021年6月21日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为10,000万元，并已全部归还至募集资金专用账户。

公司于2021年7月6日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过8,000.00万元暂时闲置募集资金用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了核查意见。

截止2024年12月31日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为5,724.40万元，并已全部归还至募集资金专用账户。

(2) 2021年非公开发行股票

本公司2021年非公开发行股票募集资金不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020年4月28日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意为了提高资金使用效率，增加现金资产收益，授权公司管理层使用额度不超过人民币50,000.00万元暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。期限为股东大会审议批准之日起至下次有权授权机构批准作出新的决议前有效。在上述额度在决议有效期内，可以滚动使用。

公司于2021年12月3日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意为了提高资金使用效率，增加现金资产收益，授权公司管理层使用额度不超过人民币250,000.00

万元的暂时闲置资金和不超过250,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止，投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

公司于2023年4月28日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意为充分利用公司闲置资金，进一步提高闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，拟授权公司管理层使用额度不超过人民币300,000.00万元的暂时闲置资金和不超过300,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品。期限为股东大会审议批准之日起至下次有权授权机构批准作出新的决议前有效。在上述额度在决议有效期内，可以滚动使用。

公司于2024年4月29日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意为了提高资金使用效率，增加现金资产收益，授权公司管理层使用额度不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置资金和不超过150,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止，投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

截止2024年12月31日，公司无对闲置募集资金进行现金管理金额。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、 2020年首次公开发行股票

截止2024年12月31日，公司前次募集投资项目实现效益情况详见附表3《2020年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

2、 2021年非公开发行股票

截止2024年12月31日，本公司前次募集实际使用情况详见附表4《2021年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

五、 报告的批准报出

本报告于 2025 年 6 月 27 日经董事会批准报出。

- 附表：1、2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3、2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
4、2021 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

斯达半导体股份有限公司



2025年6月27日

附表 1



2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			45,949.33			已累计使用募集资金总额：		46,543.94		
						各年度使用募集资金总额：		46,543.94		
变更用途的募集资金总额：			不适用			2020 年：		30,934.20		
						2021 年：		9,516.78		
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2022 年：		5,867.53		
						2023 年：		225.43		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金	募集后承诺投资	实际投资金额	募集前承诺投资	募集后承诺投资	实际投资金额	实际投资金额与	可使用状态日
			额	金额		金额	金额		募集后承诺投资	
										项目完工程
										度）
1	新能源汽车用 IGBT 模块扩产项目	新能源汽车用 IGBT 模块扩产项目	15,949.33	15,949.33	16,054.98	15,949.33	15,949.33	16,054.98	105.65	2022 年 1 月
2	技术研发中心扩建项目	技术研发中心扩建项目	10,000.00	10,000.00	10,218.03	10,000.00	10,000.00	10,218.03	218.03	2022 年 1 月
3	补充流动资金	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	20,270.93	20,000.00	20,000.00	20,270.93	270.93	不适用

附表 2



2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			347,695.05			已累计使用募集资金总额：		362,366.20		
						各年度使用募集资金总额：		362,366.20		
变更用途的募集资金总额：			不适用			2021 年：		95,972.07		
						2022 年：		47,389.98		
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2023 年：		155,215.55		
						2024 年：		63,788.60		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	使用状态日期(或 截止日项目完工 程度)
1	高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目	高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目	147,695.05	147,695.05	153,259.94	147,695.05	147,695.05	153,259.94	5,564.89	2024 年 11 月
2	SiC 芯片研发及产业化项目	SiC 芯片研发及产业化项目	50,000.00	50,000.00	55,773.42	50,000.00	50,000.00	55,773.42	5,773.42	2024 年 11 月
3	功率半导体模块生产线自动化改造项目	功率半导体模块生产线自动化改造项目	70,000.00	70,000.00	71,636.99	70,000.00	70,000.00	71,636.99	1,636.99	2024 年 11 月
4	补充流动资金	补充流动资金	80,000.00	80,000.00	81,695.85	80,000.00	80,000.00	81,695.85	1,695.85	不适用

附表 3



2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度		
1	新能源汽车用 IGBT 模块扩产项目 [注 1]	227.39%	达产年的所得税 税后利润为 5,440.00 万元	12,944.97[注 2]	14,320.14[注 2]	9,168.82[注 2]	36,433.92	是
2	技术研发中心扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：截止日投资项目产能利用率为项目达到预计可使用状态 2022 年 1 月至 2024 年 12 月 31 日止期间累计实际产量与设计产量之比。

注 2：各年度效益测算按当年募投设备折旧金额占生产设备总折旧金额比例模拟计算募投项目的销售收入、销售成本以及实际产量。

附表 4



2021 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度		
1	高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目	不适用	达产年的所得税税后利 润为 48,410.90 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	SiC 芯片研发及产业化项目	不适用	达产年的所得税税后利 润为 420,999.10 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	功率半导体模块生产线自动化改造项目	不适用	达产年的所得税税后利 润为 23,461.30 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：募投项目承诺效益约定为达产年的所得税税后利润，截止日募投项目均未达产。